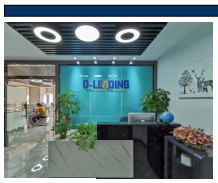
O-leading의 PCB 제조 능력 소개

O-Leading은 PCB 제조 및 PCB 조립(PCBA)을 포함한 ISO9001:2015 인증 제조업체입니다. 당사는 다양한 산업 분야에 맞춤형 PCB 및 PCBA 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 당사는 고품질 PCB 제조 및 조립 서비스를 제공하는 데 전념하고 있습니다. 당사는 다양한 산업 분야에 맞춤형 PCB 및 PCBA 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 당사는 다양한 산업 분야에 맞춤형 PCB 및 PCBA 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다.

제품 소개

층수	1층-64 층수
재료	FR-4 등
최대 보드 크기	FR-4: 1200mm
최소 폭/간격	3.5mil/3.5mil
최소 구멍 직경	0.15mm
두께	0.2mm-6.0mm
최대 종횡비	8:1 또는 10:1
표면 처리	침금, 주석 분사, 은, OSP 등
동박 두께	0.5oz-3oz(17um-105um)
솔더 마스크	녹색, 검정, 흰색, 파랑, 빨강, 노랑
실크스크린	흰색, 검정
특수 공정	임피던스 제어, 블라인드 및 매립 비아, 골드 핑거, 에지 도금
응용 분야	통신, 의료, 자동차, 산업 제어 등
납기	샘플: 1-5일, 대량 생산: 7-15일
포장	진공 포장, 골판지 상자

공장 소개



Factory PCB

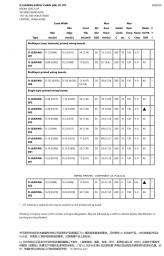
Factory SMT

인증

UL Product iQ™

ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component



배송 및 납기

Quick Turn Lead Time		
Layer Count	Lead Time	Special Requirement
1L,2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	8 days	12 days
8L	9 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

제조 및 조립

PCB 제조 능력
층수: 1 layer-32Layer
최대 보드 크기: 1-2 3oz-12oz
최소 트랙 및 간격: 3.5mil / 3.5mil
최소 홀 / 구멍 직경: 4.5mil / 4.5mil
두께: 0.2mm-6.0mm
최대 종횡비: 0.2mm-6.0mm
최대 보드 크기: 625 * 2500mm
최소 보드 두께: 4mil
Plated 홀 공차: +/- 3mil
Blind / Buried Via: 레이저 드릴
솔더 마스크 색상: 녹색, 검정, 흰색, 파랑, 빨강, 노랑
재료: FR-4, High Tg,Halogen free material, Rogers, Aluminium base,특수 재료,
표면 처리
특수 기술: HASL, CKP, ENIG, HAL-LF, 임피던스 제어, 골드 핑거, 에지 도금

SMT 조립 능력
PCB 크기: FR-4, CEM-3, CEM-1, 최대/최소 보드 크기
칩 PCB 크기: 1.52x50.8mm
칩 PCB 두께: 0.3mm
PCB 두께: 0.3mm-6.5mm
최소 칩 크기: 0.3mm
최소 칩 간격: 0201
최소 BGA 간격: 0.3mm
최소 칩 크기: 0201
최소 칩 간격: 0.3mm
최소 BGA 간격: 0.4mm
최대 BGA 크기: 0.8mm
정밀도: +/- 0.03mm